

提升半導體製程效能之重要工具。

# Stress Station

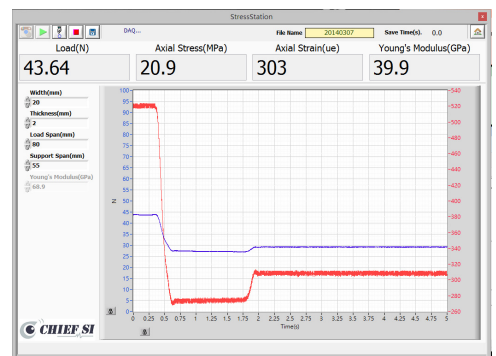


## 晶圓彎曲應力量測新趨勢：

依據國際半導體技術準則(ITRS)與英特爾 CMOS 製程技術，應力技術已經成為先進奈米 CMOS 製程(90nm 以及之後)技術之關鍵技術之一。此應力量測儀可以評估 CMOS 元件的應力，也可以同時萃取壓阻係數。同樣，此應力量測儀也可以針對不同領域進行應力研究。例如：奈米線、奈米探管、FinFET、GaAs 元件、SiGe 通道元件、Ge 通道元件、MEMS、LED、OLED、PV...等等。

## 系統特色：

- 可直接量測出待測元件的應變量。
- 晶圓彎曲夾具機構簡單、操作容易。
- 此應力量測儀已有國際 SCI 期刊使用。
- 彎曲夾具提供可變化的單軸向應力 (包含伸張及壓縮應力)。
- 應力量測儀可擴充至 應變 I-V 量測、應變低頻雜訊量測 等。



## 規格：

介面	USB 2.0	最大測試尺寸	80×100 mm
量測範圍	300 MPa <sup>*註 1</sup>	施力支點調節範圍	95 mm
應力解析度	0.05 MPa	施力支點調整間距	無段調整
應力模式	伸張應力或壓縮應力	尺寸(長×寬×高)	240×210×195 mm
楊氏係數量測	支援	重量	5 Kg
即時應力計算	支援	使用環境溫度	-20 ~ +60°C
即時位移分析	支援 (選購)	標準配件	校正片、USB 連接線、軟體光碟
應力與作用力量測	支援	支援語言	英文
最大施力	100 N	電腦基本需求	CPU:P4, HD:1GB, USB 2.0
作用力調節行程	3 mm	螢幕基本需求	1280*800 resolution
作用力調整	同步調整	支援作業系統	Windows XP, WIN 7

\*註 1: 此量測範圍是以晶圓之楊氏係數做計算依據。



Tel : +886-3-5936268  
Mail : service01@chiefsi.com.tw  
Web : www.chiefsi.com.tw